

2026年4月21日

各 位

会 社 名 東京応化工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 種市 順昭
コード番号 4186（東証プライム）
問 合 せ 先 広報IR部長 川田 哲也
TEL. 044-435-3000

日米企業による次世代半導体パッケージ開発・コンソーシアム「US-JOINT」本格稼働

東京応化工業株式会社（本社：神奈川県川崎市中原区／取締役社長：種市 順昭、以下「当社」といいます。）は、次世代半導体パッケージ分野における新たな技術開発モデルの構築を目指し、日米の材料・装置メーカーなど12社が参画するコンソーシアム「US-JOINT」が本格稼働を開始したことをお知らせします。始動にあたり、4月20日（現地時間）、米国・シリコンバレーの現地拠点にて、日米の政府関係者・参画企業などが出席した、オープニングセレモニーを開催しました。

なお、US-JOINTは米国初の、先端半導体パッケージに特化したコンソーシアムとなります。



生成AIや自動運転などの成長分野では、半導体の性能向上に伴い、後工程における先端半導体パッケージ技術の重要性が一層高まっています。一方で、新しいパッケージコンセプトが次々に生まれる中、それらを迅速かつ実践的に検証できる環境が限られていることが、技術開発のボトルネックとなっていました。

US-JOINTは、シリコンバレーに開設した研究開発拠点を活用し、先端半導体の主要ユーザーである顧客とともに半導体パッケージの最新コンセプトの検証を行います。市場ニーズをリアルタイムで捉え、日米トップメーカーの材料・装置分野の技術力と、米国の半導体ユーザーや新しいアイデアが集積する環境を掛け合わせることで、材料、評価・実装技術の研究開発を加速させ、新技術の早期実用化・事業化につなげていきます。

■US-JOINT における東京応化工業株式会社の役割

当社は 1968 年に日本で初めて半導体用フォトレジストの開発に成功して以来、フォトレジストのリーディングカンパニーとして半導体産業の発展を支え、豊かで持続可能な社会の実現に貢献してまいりました。US-JOINT においては創業以来培ってきた世界最高水準の微細加工技術と高純度化技術を活かし、高性能・高純度なフォトレジストなどの製品を通じて、次世代半導体の進化を加速させるとともに、社会の期待に化学で応える価値創造を推進してまいります。

■US-JOINT 概要

名称	US-JOINT (JOINT : Jisso Open Innovation Network of Tops)
目的	米国における次世代半導体パッケージの評価プラットフォーム創成と実装技術の開発
参画企業 アルファベット順	12 社 (2026 年 4 月 20 日時点) Azimuth Industrial、KLA Corporation、Kulicke and Soffa Industries、メック株式会社、Moses Lake Industries、ナミックス株式会社、東京応化工業株式会社、TOPPAN 株式会社、TOWA 株式会社、株式会社アルバック、3M Company、株式会社レゾナック
所在地	米国カリフォルニア州 ユニオンシティ
稼働開始	2026 年 4 月 (本格稼働)
主な設備・環境	先端半導体パッケージングプロセス (パターニング、ボンディング、モールド、めっき等)、評価・解析装置、 クリーンルーム (クラス 100, 1,000)
拠点の役割	次世代半導体パッケージのコンセプト検証を行う研究開発拠点
想定利用者	ファブレス企業、半導体メーカー、参画企業の技術者



- US-JOINT ロゴ -



- US-JOINT 参画企業 -

以上